公司代码：688388　　公司简称：嘉元科技

广东嘉元科技股份有限公司

2025 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为57,024,716.06元。截至2025年12月31日，公司母公司期末未分配利润为1,281,742,467.12元。经公司第六届董事会审计委员会2026年第三次会议及第六届董事会第三次会议审议通过，公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

1、以实施权益分派的股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为455,673,790股，扣除回购专用证券账户的股份数量2,699,900股后参与分配股数为452,973,890股，以此计算拟派发现金红利合计20,383,825.05元（含税）（实际分派现金红利金额以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数额为准），本年度公司现金分红占当年度归属于上市公司股东的净利润的比例为35.75%。

2、公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股。截至本公告披露日，公司总股本为455,673,790股，扣除回购专用证券账户的股份数量2,699,900股后参与分配股数为452,973,890股，以此计算合计拟转增股本203,838,251股，转增后公司总股本增加至659,512,041股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准，如有尾差，系取整所致）。

3、公司不送红股。

若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例和每股转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

□适用 √不适用

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	嘉元科技	688388	无

1.2公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李恒宏	杜宗宣
联系地址	广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村	广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村
电话	0753-2825818	0753-2825818
传真	0753-2825858	0753-2825858
电子信箱	688388@gtjy.sjxt.net	688388@gtjy.sjxt.net

2、报告期公司主要业务简介

2.1主要业务、主要产品或服务情况

1、公司主要业务概况

公司主要从事各类高性能电解铜箔和高性能精密铜线的研发、生产和销售，公司深耕铜箔行业20余年，在技术研发、生产管理、工艺创新、人才培养等方面积累了丰富的经验，处于行业领先地位。公司产品按下游应用领域可以分为锂电铜箔、电子电路铜箔和高性能精密铜线，铜箔产品分别用于各类锂电池和覆铜板/印刷电路板的制造，铜线产品主要用于电力、通信、汽车和新能源等领域。

2、公司主要产品及应用

公司主要产品为锂电铜箔、电子电路铜箔、高性能精密铜线，主要产品规格为3.0-20μm各类高性能锂电铜箔、9-140μm各类电子电路铜箔产品。铜箔产品主要应用于锂离子电池、覆铜板和印制电路板行业；高性能精密铜线产品主要为0.08-0.254mm的裸铜绞线和镀锡绞线，主要应用于电力、通信、汽车、新能源等领域。

报告期内，公司生产和销售的主要锂电铜箔产品及下游应用情况如下：

序号	类别	产品代码	规格（μm）	特征值	主要应用场景
1	普强系列	JYPC03	3.0	抗拉强度（MPa）：300-400	动力/飞行器
2		JYPC04	4.0		动力/飞行器
3		JYPC045	4.5		动力/储能/飞行器
4		JYPC5	5.0		动力/储能
5		JYPC6	6.0		动力/储能
6		JYPC8	8.0		3C数码/动力/储能
7		JYPC10	10.0		3C数码/动力/储能
8		JYPC12	12.0		3C数码
9		JYPC14	14.0		3C数码
10		JYPC16	16.0		3C数码
11		JYPC20	20.0		3C数码
12	中强系列	JYZC5	5.0	抗拉强度（MPa）：400-500	动力/储能
13		JYZC6	6.0		动力/储能
14		JYZC9	9.0		3C数码
15	高强系列	JYGC4.5	4.5	抗拉强度（MPa）：500-600	动力/飞行器
16		JYGC5	5.0		动力/3C数码
17		JYGC6	6.0		动力/储能/3C数码
18		JYGC7	7.0		动力/3C数码
19		JYGC8	8.0		3C数码
20		JYGC10	10.0		3C数码
21	超高强系列	JYGC4.5	4.5	抗拉强度（MPa）：600-700	动力/3C数码/飞行器
22		JYGC5	5.0		动力/3C数码/飞行器
23		JYGC6	6.0		动力
24		JYGC8	8.0		3C数码
25		JYGC10	10.0		3C数码
26	特高强系列	JYTGC4.5	4.5	抗拉强度（MPa）：≥700	动力/3C数码/飞行器
27		JYTGC6	6.0		动力/3C数码/飞行器
28		JYTGC8	6.0		动力/3C数码/飞行器
29	高延系列	JYGY6	6.0	延伸率（%）：≥12	3C数码/储能
30		JYGY8	8.0	延伸率（%）：≥15	3C数码/储能
31		JYGY10	10.0	延伸率（%）：≥17	3C数码/储能
32		JYGY12	12.0	延伸率（%）：≥20	3C数码/储能

报告期内，公司生产和销售的主要电子电路铜箔产品及下游应用情况如下：

序号	类别	产品名称	产品代码	规格um	特征值	适用基材	应用场景
1	高频	RTF高频-R1	RTF-F-R1	12-70	Rz:3.0-4.0um	PTFE、碳氢树脂（PCH）	PTFE
2		RTF高频-R2	RTF-F-R2	12-70	Rz:3.8-4.8um，较高抗剥离	PTFE、碳氢树脂（PCH）、陶瓷基材	PTFE、陶瓷、对抗剥离要求高PTFE高频材料
3		RTF高频-R3	RTF-F-R3	12-70	Rz:3.2-4.0um，高耐热、强抗剥离	PTFE、陶瓷基材，高频碳氢树脂	5G 宏基站高频板、毫米波射频前端、高端射频器件
4		RTF高频-R4	RTF-F-R4	12-70	Rz:2.5-3.2um，超低插损，高耐化性	Ultra low loss 高频树脂、PTFE/陶瓷复合基材	6G 预研、卫星通信、车载毫米波雷达高频板
5	高速	RTF高速-R1	RTF-D-R1	12-105	Rz:3.0-4.0um	Mid loss/FR-4/PPO	一般高速产品
6		RTF高速-R2	RTF-D-R2	12-105	Rz:2.0-2.5um	Low/Mid loss /FR-4/PPO	Rz低于2.5um的高速材料
7		RTF高速-R3	RTF-D-R3	12-105	Rz:1.5-2.0um，低传输损耗，高平整	Low loss、Mid loss、High Tg FR-4	中高速服务器、5G 接入网、企业级交换机
8		RTF高速-R4	RTF-D-R4	12-105	Rz:1.0-1.5um，超低损耗，高信号完整性	Ultra low loss、Low loss、特种高速树脂	高速核心交换机、AI 边缘计算、数据中心中高速板
9	高频高速	HVLP1代	HVLP-D-N1	12-105	Rz:1.5-2.0μm，低轮廓、高附着力	Mid loss、Low loss、FR-4、PPO	中低端高速 PCB、5G 小基站、普通 AI 服务器
10		HVLP2代	HVLP-D-N2	12-105	Rz:1.0-1.5μm，超低轮廓、高信号保真	Low loss、Mid loss、PTFE、PPO	中高端高速通信、AI 边缘服务器、5G 基站射频板
11		HVLP3代	HVLP-D-N3	12-105	Rz:0.5-1.0μm	Low loss/Mid loss/PTFE-/PPO/PTFE	中高端 AI 服务器、5G 基站、高速交换机
12		HVLP4代	HVLP-D-N4	12-105	Rz ≤0.6μm	Ultra low loss/Low loss/PTFE/PPO/特种树脂	高端 AI 加速器、77GHz 汽车雷达、卫星通信、超高速数据中心
13	红铜	常规红铜	PCF-E-L	10-105	毛面红化	PCCL柔性覆铜板基材	PCCL、PPCB
14	常规箔	常规箔HTE	HTE-P	10-140	红化	FR-4/High Tg	PCB
15		常规箔HTE	HTE-C	12-140	红化	FR-4/High Tg	CCL

报告期内，公司生产和销售的主要高性能精密铜线产品及下游应用情况如下：

序号	类别	产品名称	产品型号	核心性能	规格	应用场景
1	精密高性能	镍钢绞线	TJR	柔软性好，可显性高，强度大，稳定性好	0.04mm、0.05mm、0.06mm、0.08mm、0.10mm、0.12mm、0.15mm、0.25-8mm	电力设备：高低压电器、真空电路器、高低压开关柜、焊接设备、硅整流设备、电缆外架接地、封闭母线槽、变压器安装 交通与工业：汽车、电力机车、工业电炉、矿用的爆电器 特殊连接：发电机组、磨刷导线的软连接等
2	高精高速	镀铜绞线	TJXR	抗氧化性优异，高导电性好，信号传输稳定	0.04mm、0.05mm、0.06mm、0.08mm、0.10mm、0.12mm、0.15mm、0.26-8mm	通信领域：5G通信电子导线，信号线，高速传输数据线缆，军工通讯线缆 医疗与交通：医疗线缆，智能汽车电子线束 新能源：新能源光伏导线中的导体 特殊信号：铁路数字信号电缆

2.2主要经营模式

公司主要从事各类高性能电解铜箔和高性能精密铜线的研发、制造和销售业务，现有的经营模式是根据行业特点确定的，公司根据自身情况，市场规则和运行机制，进行日常生产经营活动，主要经营模式如下：

1、盈利模式

报告期内，公司的盈利主要来自为客户提供高性能电解铜箔产品和高性能精密铜线产品的销售收入与成本费用之间的差额。公司通过持续研发实现技术创新，不断提升生产工艺水平，提高产品附加值、优化产品结构，以满足客户需求，并通过不断改进和优化生产线以提高生产效率、提高运营管理能力，从而不断增强公司核心竞争力和盈利水平。

2、采购模式

公司生产电解铜箔产品采购的原材料主要是阴极铜，具体形态为铜线或铜板，其他辅料包括硫酸和各种添加剂。阴极铜和硫酸属于大宗采购商品，市场价格透明，货源充足，公司有稳定的供应渠道，与供应商建立了稳定良好的合作关系。针对阴极铜，公司的采购价格参考公开市场或个向供应商点价定价，针对其他辅料，公司通过询比议价的方式确定供应商并签订采购合同。为保障采购工作的稳定高效，公司制定了一系列与采购相关的规章制度，从供应商选择、流程管理、价格询比和品质管控等多个方面对采购工作进行了规范。

3、生产模式

公司生产采取“以销定产”的原则制定生产计划，建立了完善的生产管理制度。公司于每年底根据订单制定下一年产销总体目标，并编制生产计划，公司每月会根据市场和客户订单情况动态调整下月生产计划。生产部根据生产计划，按客户要求、订单期限和生产工艺组织生产；技术研发部根据客户的要求进行工艺选择和参数调整；品质部根据产品检验规章对生产过程和产品质量进行最终检验，以保障质量体系的有效运行，检验合格的产品包装入库；销售部根据合同订单按期发货。

4、营销模式

公司产品主要采用直销模式，同时存在部分经销。客户主要为锂电池制造商。对于有着长期稳定合作关系的主要客户，公司一般与其签署框架采购合同或战略合作协议，约定报价方式、付款方式、质量要求等一般性规定；在合同年度内，客户根据自身生产需求向公司下达采购订单，约定产品类型、购买数量、采购金额、交货时间等具体内容；公司根据订单及自身库存和生产情况，安排采购和生产相关事宜。

5、研发模式

公司紧扣行业技术发展趋势，建立了以“市场需求导向、技术前瞻布局、产业协同创新”为核心的研发战略，深度整合公司省重点实验室研发平台、产学研合作平台及产业链协同开发平台，构建了从需求调研、立项评审、过程管控、成果验收到知识产权保护的全流程研发管理体系，为长期底质量发展提供坚实技术支撑。

2.3所处行业情况

(1)、行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

（1）公司行业分类

公司主要从事各类高性能电解铜箔的研究、制造和销售，主要产品为锂电铜箔、电子电路铜箔，主要用于锂离子电池的负极集流体、覆铜板（CCL）、印制电路板（PCB）的制造。

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754 2017），公司主营业务属于“39 计算机、通信和其他电子设备制造业”之“398 电子元件及电子专用材料制造”之“3985 电子专用材料制造”。

根据中国证监会发布的《上市公司行业统计分类与代码》，公司所属行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。

（2）公司所处行业发展现状

①铜箔行业规模

根据高工锂电（GGII）调研数据显示，2025年受益于下游需求拉动，国内锂电铜箔出货量同比增长超36%，达94万吨。展望2026年，行业增长动能持续，预计全年出货量将达115万-120万吨，产品结构向极薄和高强、高延加速迭代，量价开启趋势明确。

根据互联网公开数据，2025年国内电子电路铜箔出货量同比基本持平，约为45万吨，行业呈现高端高景气、中低端承压、国产替代加速 .A1算力驱动的结构性分化格局。

2025年中国铜箔行业呈现结构性分化：锂电铜箔量价齐升.PCB铜箔高端紧俏低端过剩，成为全球铜箔产业核心引擎。

根据高工锂电（GGII）调研数据显示，2025年受益于下游需求拉动，国内锂电铜箔出货量同比增长超36%，达94万吨。展望2026年，行业增长动能持续，预计全年出货量将达115万-120万吨，产品结构向极薄和高强、高延加速迭代，量价开启趋势明确。

根据互联网公开数据，2025年国内电子电路铜箔出货量同比基本持平，约为45万吨，行业呈现高端高景气、中低端承压、国产替代加速 .A1算力驱动的结构性分化格局。

2025年中国铜箔行业呈现结构性分化：锂电铜箔量价齐升.PCB铜箔高端紧俏低端过剩，成为全球铜箔产业核心引擎。

根据高工锂电（GGII）、EVTank等三方咨询机构的相关数据显示，在全球新能源转型背景下，锂电池出货量攀升，为锂电铜箔奠定需求基础，2025年全球锂离子电池出货量达2280.5GWh，中国锂电池行业领先全球，2025年出货量达1888.6GWh，同比增长5.5%，占全球82.8%，为锂电铜箔需求提供核心保障。

2026年，在电动车和储能电池需求继续高增长的背景下，根据高工锂电（GGII）、EVTank等三方咨询机构的相关数据显示，全球锂电池总出货量有望突破2.5TWh。此外，2026年3月中东地缘冲突加剧，导致原油价格中枢在中期维度抬升，将会进一步推动全球能源进口国对新能源产品的需求，中国乃至全球的锂离子电池出货量有望进一步加速发展。

a、2026年预计动力电池总需求超1700GWh，同比增长19%

根据高工锂电（GGII）数据，预计动力电池市场维持20%增长。2026年购置税退税，但以旧换新补贴续力释放，托底2026年销量，新能源车卡钠氟保持爆发式增长，根据第一商用车网最新发布的交强险数据显示，2025年国内新能源重卡累计销售23.11万辆，同比增长182%，渗透率接近30%，预计2026年渗透率有望进一步提高，并由短途场景（如港口、矿区）向干线物流等长途场景加速渗透。根据中汽协预测数据，预计2026年国内新能源车销量达1900万辆，同比增长15%，欧洲补贴退坡消化完毕，但新车周期启动，美国和意大利政策加码，虽然美国需求放缓，但综合下来全球预期总销量超过2400万辆，同比增长14%。同时考虑国内车辆大型化+专用车占比提升，预计动力电池总需求超1700GWh，同比增长19%。

b、储能电池增速预计超38%，出货量有望突破300GWh

储能电池需求高速增长，拉动锂电行业进入新的增长周期。储能需求的增长除了配套风光发电之外，AIDC电源侧的需求也进入爆发式增长阶段。由于储能项目多为招标性质，因此难以预测趋势，但考虑欧美自建电网的实施难度和超长周期，以及海外制造业回归需求的迫切性和AIDC需求的高增长，根据EVTank数据，预计2026年储能电池需求增速有望超38%，出货量有望突破300GWh。

综上所述，电解铜箔作为锂离子电池重要的原材料之一，起到承载负极活性材料、汇集电子并导出电流的作用。随着原油价格中枢的抬升，新能源汽车渗透率进一步成熟和应用升级，储能产业继续高速增长，锂电铜箔的需求量仍旧会不断加速提升。

③下游覆铜板CCL行业发展现状

电子电路铜箔作为CCL基材之一，间接应用于PCB领域。多份2026年发布的行业分析报告指出，2025年中国CCL市场呈现总量稳增、结构爆发，国产替代加速，高端供给失衡的特征，全年市场规模约为628.7亿元，同比增长约5.1%。中国CCL产量占全球产量约73.5%，已成为全球CCL产业绝对核心。预计2026年中国CCL产业将进入AI算力驱动的高端产能扩张年，全年总产值预计达672.4亿元，同比增长6.9%，高性能CCL占比将突破55%，M8/M9 级AI服务器CCL与车规级高导热CCL成为增长引擎，头部企业通过技术突破与产业链协同，加速抢占高端市场，行业集中度有望进一步提升。

a、AI服务器与新能源汽车驱动高端品类量价齐升

受益于海内外科技巨头加大AI领域投入，AI服务器、交换机、光模块等算力硬件需求持续增长，同时AI算力硬件驱动PCB向高密度、高性能方向升级，高阶HDI、高多层板需求大幅增加。此外，消费电子需求复苏，以及汽车电动化/智能化发展，也加大了对PCB的需求。

AI算力业务带动高端覆铜板需求的规格标准，并推动对极致性能、信号完整性和热管理能力的需求升级，行业正朝着系统级印制电路板方向转型，即将多种功能集成到单一、高度复杂的解决方案中。最少开根源，NVIDIA的GB200采用了22层5阶HDI板，而下一代Rubin平台可能需要更先进的24层6阶板，单台 AI 服务器 CCL 用量为传统服务器的3-5倍，M8级CCL单月出货突破10万张，M9级成为行业技术制高点。这极大地提高了行业整体的技术要求，利好拥有先进研发和制造能力的厂商。新能源车PCB用量为燃油车的4-5倍，车规级CCL需求持续高增，国产化率仍有提升空间。

相应地，AI服务器与新能源汽车加速发展对高端PCB的需求，自然需要高端CCL产品的支持，并进一步转化为对高端电子电路铜箔的需求。HVLP极低轮廓铜箔成为高频高速CCL标配，2025年全球高端HVLP产品供不应求，产品量价齐升。

b、中低端产能被挤压，变相加速出清

AI算力加大对高端覆铜板需求，也即增加了对高端电子电路铜箔的需求。高端产品价格高，其需求的高速增长自然带动行业中低端产能往高端产品切换。同时，高端产品良率更低，为满足更多高端产品需求，对中低端产品产能的挤出影响会更突出。与此同时，中低端产品需求并未消失。而中低端产品价格在2025年并未有明显上涨，导致铜箔厂扩产并不积极，进一步导致了行业的供需不平衡，形成了“变相”的加速出清。

④行业主要技术门槛

a、通用核心技术门槛（全品类铜箔）

● 电解液与添加剂配方壁垒：铜箔电解液配方、光亮剂、整平剂、润湿剂等添加剂体系为核心技术机密，直接决定铜箔结晶结构、力学性能、表面粗糙度。高端铜箔添加剂需长期研发迭代，无公开标准，依赖企业自主研发与工艺积累，配方藏以仿制、外溢性极低，是企业核心技术护城河。

● 全流程精密工艺控制壁垒：电解生箔、表面处理、水洗、烘干、分切等全流程需对电流密度、温度、pH 值、走速、张力等数十个参数进行毫秒级闭环控制，工艺窗口极窄，微小波动即可导致铜箔针孔、划痕、厚度不均、力学性能不达标，需多年生产数据积累与工艺优化能力。

● 量产良率管控壁垒：铜箔规模化生产中良率直接决定成本与盈利能力。头部企业可实现90%以上的稳定良率，中小厂商良率偏低，成本劣势显著，无法参与高端市场竞争。

b、锂电铜箔专用技术门槛

● 极薄化高精度成型壁垒：主流向6μm以下极薄化发展，厚度越薄，连续稳定生产控制难度呈指数级上升，无针孔、无暗斑、无断带，对电解工艺、设备精度、添加剂体系提出极致要求。

● 高力学性能适配壁垒：随着电池技术迭代，动力电池/储能电池/数码电池均要求铜箔具备高抗拉强度、高延伸率，适配高镍三元、4680大圆柱、快充等技术路线。需兼顾“高强度+高延伸”双重指标，常规铜箔无法满足，依赖晶粒细化与晶体取向调控技术。

● 低缺陷表面质量壁垒：要求低毛刺、低粗糙度、低杂质，避免刺破隔膜，引发电池短路，提升电池循环寿命与安全性。表面处理工艺直接影响负极材料粘接强度，是电池安全性与可靠性的关键保障。

c、电子电路铜箔专用技术门槛

● 极低轮廓（HVLP）加工壁垒：At 服务器/高速通信 PCB 要求极低轮廓铜箔（HVLP），表面粗糙度Rz≤0.6μm（HVLP4）、Rz≤0.5μm（HVLP5）。需实现铜晶粒极致细化、表面极致平整，保证高速信号完整性、低传输损耗，是高端 PCB 铜箔核心壁垒。

● 高频高速信号适配壁垒：高频高速 CCL 配套铜箔需满足低介电损耗、高耐热性、高尺寸稳定性等，通过 224Gbps + 高速传输、多层数 AI 服务器板。铜箔晶体结构、表面形貌、耐热膨胀系数需与高端/特种树脂、石英布高度匹配，技术协同难度极高。

● 特殊表面处理与粘接壁垒：需通过反转处理（RTF）、粗化处理、耐热钝化处理，保证铜箔与树脂基材的高剥离强度、高耐化性、高耐热冲击性。处理层均匀性，结合力直接决定PCB可靠性，是高端PCB铜箔核心技术难点。

d、认证与客户验证壁垒

● 下游认证周期长：锂电铜箔进入头部电池厂认证周期12-24个月（视具体情况而定）；PCB铜箔进入CCL厂及AI服务器供应链认证周期长—12个月（视具体情况而定）。

● 车规级/高端工业证书：需通过IATF16949、AEC-Q200等体系认证，验证严苛、替换成本高，客户黏性极强。

e、规模化与绿色制造壁垒

● 铜箔为连续化大工业生产，规模效应显著，小产能无法摊薄设备、能耗、人工成本。

(2)、公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是中国锂电铜箔领域第一梯队龙头，以“高端超薄铜箔技术壁垒+头部客户深度绑定+产能持续扩张”为核心竞争力，整体市场份额稳居行业前列。公司2025年实现扭亏为盈，与宁德时代签署2026年-2028年计划向其提供不低于62.6万吨产能的要求优先保障铜箔产品需求并提供有竞争力的价格方案的战略合作框架协议，进一步巩固核心供应商地位。截至2025年底，公司年产能达13.5万吨，规划总产能25万吨。核心生产基地包括：广东梅州（总部）、山东聊城、江西赣州、福建宁德，形成全国性布局。

公司掌握八大核心技术，涵盖铜箔强度（＞800MPa）、延伸率（＞20%）等关键参数调控技术。累计授权专利446项（发明专利211项），建立国家企业技术中心、国家技术创新示范企业等科研平台。公司在高粘粗化、晶体取向调控、表面处理等领域形成独特技术优势，极薄铜箔良率达90%以上。公司在极薄铜箔与固态电池铜箔领域形成不可替代的技术壁垒，是管面临行业竞争与技术迭代挑战，但凭借技术优势、客户资源与产能布局，公司将不断巩固全球高端铜箔龙头地位，引领行业发展。

(3)、报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

2025年，铜箔行业正围绕极薄化、复合化、高端化、数智化、绿色化全面升级。

a、新技术

● 3.5-6.0μm极薄/高抗拉强度/高延展性锂电铜箔：厚度以3.5μm、4.5μm、5.0μm、6.0μm为主，并且在极薄要求下，抗拉强度和延展性的要求并未降低，行业通过晶粒细化、纳米孪晶、合金化及电沉积工艺优化，在提升抗拉强度以满足高速制程与结构稳定性的同时，同步改善延伸率，适配大圆柱卷绕、硅基负极膨胀及高温工况，实现强韧一体化与热稳定性升级，随着铜价不断上涨，降低采购成本成为锂电池厂重点关注方向，铜箔极薄化和高抗拉强度及高延展性成为主要技术趋势。

● HVLP超低轮廓铜箔：表面粗糙度极低（Rz＜1.0μm）和HVLP5（≤0.8μm）和HVLP5（≤0.5μm），主要适配AI服务器、高速PCB、光模块、先进封装等高频高速场景。

b、新产业

公司代码：688388　　公司简称：嘉元科技

广东嘉元科技股份有限公司

2025 年度报告摘要

● AI算力铜箔产业：聚焦HVLP铜箔、RTF铜箔、IC载板铜箔、FC-BGA专用铜箔等高端领域，是AI服务器、数据中心、光模块等算力基础设施的核心材料，需求持续爆发。

● 固态电池专用铜箔产业：主打多孔、合金、耐腐蚀、高界面适配特性，解决固态电池电解质腐蚀、界面接触等问题，适配硫化物/氧化物电解质，处于快速迭代量产阶段。

c、新业态

● 向负极材料解决方案延伸：企业从“单纯销售铜箔”转型为“提供负极集流体整体解决方案”，可根据客户需求（电芯能量密度、循环寿命、成本目标）定制铜箔，并提供工艺指导、测试等一体化服务。

● 柔性定制可快速反应：适配AI算力、固态电池等新兴场景，实现小批量、多品种生产，交付周期缩短至7-10天，提升客户响应效率。

● 链主协同创新：以铜箔企业为核心，联合电池厂商、设备厂商、车企开展联合开发，同时联动高校、研究院共建实验室，加速新技术、新产品落地。

● 绿色低碳制造：采用“原生铜+再生铜”混合生产模式，搭配光伏、风电等绿电，减少碳排放，降低碳足迹，同时实现废水、废箔循环利用，满足ESG要求，践行社会责任。

d、新模式（核心盈利模式）

● 高附加值技术溢价：放弃普通铜箔规模内卷，聚焦HVLP、超薄、高强、高延等高端产品，加工费较普通铜箔更高，毛利率大幅提升，头部企业订单充足。

● 垂直一体化：上游延伸至铜矿、再生铜项目，锁定原材料供应，降低成本；下游参股电池、PCB企业，绑定长期订单，保障产能利用率。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	14,730,130,406.33	13,044,744,141.71	12.92	12,801,157,212.95
归属于上市公司股东的净资产	6,939,963,622.13	6,902,066,004.19	0.55	7,165,167,621.25
营业收入	9,643,343,442.80	6,522,268,970.73	47.85	4,968,597,194.80
利润总额	83,963,376.19	-283,784,138.68	不适用	24,643,496.80
归属于上市公司股东的净利润	57,024,716.06	-238,831,043.21	不适用	19,030,463.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,966,463.36	-284,194,986.06	不适用	-27,822,493.61
经营活动产生的现金流量净额	-116,086,929.50	-1,253,809,704.26	不适用	666,503,327.48
加权平均净资产收益率(%)	0.82	-3.40	增加4.22个百分点	0.26
基本每股收益（元/股）	0.13	-0.56	不适用	0.04
稀释每股收益（元/股）	0.13	-0.56	不适用	0.04
研发投入占营业收入的比例(%)	4.84	4.20	增加0.64个百分点	4.74

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	1,980,800,989.57	1,982,116,832.23	2,577,204,143.31	3,103,221,480.69
归属于上市公司股东的净利润	24,456,429.96	12,297,689.73	4,121,927.96	16,148,689.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,327,490.47	2,027,833.48	1,016,531.00	594,608.41
经营活动产生的现金流量净额	-464,410,173.30	520,136,353.66	23,598,548.99	-195,411,658.85

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	20,316
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	23,863
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
山东嘉元实业投资有限公司	0	90,300,270	21.18	0	无	0	境内非国有法人
赣州发展投资基金管理有限公司-赣州发展定增参与投资基金（有限合伙）	-5,280,574	11,461,693	2.69	0	无	0	其他
赖仕昌	-1,061,370	11,243,433	2.64	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	3,450,473	6,070,786	1.42	0	无	0	其他
深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司-嘉远创新科技股份节证开投资基金	0	4,329,896	1.02	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-嘉远创新科技股份节证开投资基金	4,200,233	4,200,233	0.99	0	无	0	其他
广东华能私募基金管理有限公司-华能先进制造5号私募证券投资基金	0	4,086,600	0.96	0	无	0	其他
上海道禾长期投资管理有限公司-上海临港新片区道禾一期产业资产股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	3,175,257	0.74	0	无	0	其他
王征	3,050,000	3,050,000	0.72	0	无	0	境内自然人
赣和资本管理（深圳）有限公司-赣和叶盛一号私募证券投资基金	-2,638,326	3,021,674	0.71	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东赣仕昌、华能先进制造5号私募证券投资基金存在一致行动人关系，具体详见公司2022年6月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于股东增加一致行动人及一致行动人之间内部确认控股行为暨权益变动提示性公告》（公告编号：2022-066）。除此之外，公司未知前上述其他股东有存在关联关系或一致行动人协议的声明，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入9,643,343,442.80元，较上年同期相比增加47.85%；归属于上市公司股东的净利润57,024,716.06元，较上年同期相比增加295,855,759.27元，实现扭亏为盈。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688388　　证券简称：嘉元科技　　公告编号：2026-050

广东嘉元科技股份有限公司关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予第一个归属期符合归属条件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次拟归属限制性股票数量及人数：首次授予部分第二个归属期符合归属条件的激励对象共计136名，可归属的限制性股票数量为72.4170万股；预留授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象共计31名，可归属的限制性股票数量为15.4200万股；

● 归属股票来源：广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）自二级市场回购的公司A股普通股股票。

一、股权激励计划批准及实施情况

（一）本次股权激励计划的主要内容

公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）分别于2024年4月24日、2024年5月15日经第五届董事会第二十一次会议、2023年年度股东大会审议通过，其主要内容如下：

1、股权激励方式：第二类限制性股票。

2、授予数量（调整前）：本激励计划拟向激励对象授予291.50万股限制性股票，占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.68%。其中，首次授予251.38万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.59%，首次授予部分占本次授予权益总额的86.24%；预留40.12万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.09%，预